

证券代码： 301536

证券简称：星辰科技

星辰科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-007

投资者关系活动类别	<div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input type="checkbox"/>其他（请文字说明其他活动内容）</div>
参与单位名称及人员姓名	（排名不分先后）信达澳亚、博时基金、汇添富、国投瑞银、长盛基金、先锋基金、东方阿尔法、诺安基金、景顺长城、宝盈基金、平安基金、嘉实基金、长城基金、前海开源、大成基金、国联基金、华西基金、金信基金、尚正基金、融通基金、华泰证券、华金证券、国泰海通、中信证券、中信建投、财通证券、天风证券、光大证券、平安证券、中泰证券、东北证券、浙商证券、江海证券等 40 家机构与个人
时间	2025 年 12 月 26 日
地点	深圳湾万丽酒店 3 楼会议室现场调研
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理林永育 财务负责人兼董事会秘书萧培君
投资者关系活动主要内容介绍	<div>1、请公司更新一下最新的经营情况，公司如何看待今年及后续一段时间的成长？</div> <div>答：公司发展已进入关键转折期，前期在端边侧 AI SoC 芯片领域的研发投入已积累至成果集中产出阶段，业务将从稳健增长步入快速增长；同时受益于车载、机器人、3D 感知等前沿赛道项目的落地与放量，快速成长的态势预期可持续较长一段时间。</div> <div>近期公司经营基本面持续向好，海外市场布局成效显著，车载前装等核心项目逐步落地，推动产品结构持续优化并向中高端升级，进而带动营收与盈利水平的提升。此外，外延并购作为公司扩大业绩规模的辅助手段，将与内生增长形成高度协同，进一步提升公司竞争力。具体经营数据请以公司后续披露的定期报告为准。</div>

**2、请公司介绍一下 2025 年开发者大会的主要新品情况。**

**答：（1）车载激光雷达：**公司发布车规级 dToF 激光雷达 SPAD 芯片 SS905HP（高线数）与 SS901（低线数）形成高低搭配，覆盖超 1000 线至 192 线分辨率的长距离应用；其中，SS905HP 最大探测距离 300-600 米，系统架构较传统 SiPM/APD 方案更简化，在可靠性、功耗、体积等核心指标上业内全面领先。

**（2）车载视觉感知&辅助驾驶：**公司全新推出 12nm 工艺 SAC8905，定位 L2 级辅助驾驶，集成 32TopsNPU，支持 BEV、Transformer 先进算法，适配前视一体机、行泊一体场景，2027 年将联合国际车厂正式量产；SAC8712，定位 L1 级辅助驾驶，具备低功耗优势，已导入多家 Tier1，2026 年上半年将批量发货；SAC8901/SAC8902，定位舱内外视觉感知，适配 DVR、DMS、CMS 等场景，其中 SAC8901 已在理想等新势力车企完成交付，将于 2026 年上半年交付至一汽大众等车厂；SAC8902 将配套国际车厂于 2026 年上半年交付。

**（3）边缘计算：**公司发布 SSR670，集成 8Tops 算力与本地大模型，支持 32 路解码，可视客户需求搭配可拓展的算力架构，落地高端边侧智能硬件（如 NVR、NAS、Homebase 等场景）。

**（4）智能机器人：**公司发布第三代机器人芯片 SSU9366，适配户外、陪伴等机器人。同时将尽快推出面向具身智能机器人大小脑的 SoC 芯片，规划分布式算力芯片组（覆盖 16T-128T），以极致算力功耗比和分布式算力架构赋能更多类型的机器人产品。

**（5）移动视觉：**公司发布 ISP6.0，HDR 动态范围达 140dB，支持 AI HDR 算法消除鬼影；EIS 新增地平线锁定功能，实现领先的运动防抖效果；搭配色彩引擎及升级 3A 算法，可适配公司第二代智能眼镜及其他移动影像设备的动态场景。

**（6）智能工业：**公司发布新一代智能 PLC 主芯片 SSD2366GI，可满足控制、分析、通信并行处理及工业 AI 多模态推理需求，后续将沿“工业 HMI→工业 PLC→工业机器人→人形机器人”路径持续拓展，赋能工业自动化升级。

具体可参照公司官方公众号及视频号所介绍的相关内容。

**3、大会上公司有提到在 5 年内目标成为市场最领先的车载视觉供应商，如何理解这个目标？公司有什么核心策略？**

答：公司该目标聚焦 L2 级及以下与视觉相关的全场景（含 DMS、CMS、车载 DVR、行泊一体等），该市场体量庞大且竞争格局相对清晰。

公司核心策略如下：一方面深耕海内外客户，目前相关产品已在 30 + 家海内外客户导入量产或即将量产，其中海外重点突破日本市场，明年将有更多项目落地。另一方面聚焦高确定性的优势赛道，避免业内同质化竞争。同时依托技术与供应链优势，保障产能与成本优势，持续扩大份额。

**4、公司为何会选择大部分的 SoC 芯片均内置存储的模式？存储涨价对公司的影响如何理解？公司如何应对？**

答：公司以“芯片+内置存储”一体化方案为客户提供“交钥匙”服务，具备独特商业模式与全栈式服务优势，形成差异化壁垒。公司每年 KGD 采购量过亿级，与多家主流存储供应商密切合作，凭借规模效应优先锁产能、争最优价，快速保障供应。

在行业缺货背景下，许多客户因外挂存储缺货、价格暴涨而转向公司的内置存储产品，带来增量订单的同时也提升了定价能力。公司则通过长期协议锁产能、靠规模效应保性价比，将供应链能力转化为增长动力与竞争壁垒。

**5、公司目前在海外生态的拓展情况如何？后续是否有机会导入海外头部的端侧大客户？**

答：公司全球布局广泛，直接与间接销售的海外占比过半，目前已与多个国家或地区的主流客户建立合作，也是海外智能视觉市场最主要的芯片供应商。

公司后续导入海外头部端侧大客户的时机明确，各类海外头部客户推出的端侧大模型正持续发展，其应用场景的落地亟需视觉相关 SoC 芯片配

	<p>套，公司将持续积极接洽。得益于公司产品矩阵多元、视觉效果认可度高、算力功耗成本平衡适配需求，且拥有强有力的海外技术支持团队可快速响应需求，公司有信心未来能够配合客户实现快速成长。</p> <p><b>6、公司车载激光雷达芯片是否已有客户？如何看待和国内其他类似友商的对比？</b></p> <p>答：公司车载激光雷达芯片已进入客户对接落地阶段，第一批产品将于 2026 年上半年量产。公司目标成为中高端车载激光雷达芯片领域，技术与市场双领先的核心供应商。</p> <p>公司产品定位是中高端差异化，目前国内多采用分立器件方案，存在体积大、功耗高、集成度低等问题，而公司 SPAD 芯片实现“变小、变轻、高集成”，在线数、分辨率、探测距离、点云密度、可靠性上均在业内具备显著优势。</p> <p><b>7、公司的机器人芯片业务今年增长非常快，出货量超过千万颗，如何看待后续的增长？</b></p> <p>答：公司机器人业务后续增长具备确定性，目前正在拓品类及中高端化，已陆续切入大型户外机器人、陪伴机器人、工业协作机器人等多个细分领域。同时将尽快推出面向具身智能机器人大小脑的 SoC 芯片，配合算力拓展架构，最高可覆盖至 128T。</p> <p>公司核心瞄准“泛机器人赛道”，所有具备感知、控制、决策功能的智能设备，无论形态是否为人形，均属于公司的目标市场。公司可依托现有技术平台快速适配新品，未来目标成为泛机器人赛道领先的芯片供应商。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025-12-26